证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-054

# 上海硅产业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月28日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 |
| 普通股股东人数 | 834 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,163,201,213 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,163,201,213 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.3416 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.3416 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长姜海涛先生、副董事长冯倩女士由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事、总裁邱慈云先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,160,662,483 | 99.7817 | 1,954,548 | 0.1680 | 584,182 | 0.0503 |

2、议案名称：关于2025年度申请直接债务融资产品额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,161,310,276 | 99.8374 | 1,373,891 | 0.1181 | 517,046 | 0.0445 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案 | 593,662,483 | 99.5741 | 1,954,548 | 0.3278 | 584,182 | 0.0981 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：1。回避表决的关联股东名称：1，上海国盛（集团）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、李淼儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-056

# 上海硅产业集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月28日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的建设期延长至2026年12月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元人民币，募集资金总额为人民币4,999,999,851.17元，扣除发行费用人民币53,814,364.71元后，实际募集资金净额为人民币4,946,185,486.46元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2022）第0162号《验资报告》予以确认。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年及2024年披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露，本次募集资金主要用于“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”、“300mm高端硅基材料研发中试项目”和“补充流动资金”，具体使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金使用金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目 | 460,351.20 | 150,000.00 |
| 2 | 300mm高端硅基材料研发中试项目 | 214,420.80 | 200,000.00 |
| 3 | 补充流动性资金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | | 824,772.00 | 500,000.00 |

三、本次部分募投项目延期情况

（一）募投项目基本情况

“300mm高端硅基材料研发中试项目”实施主体为公司控股子公司上海新傲科技股份有限公司（以下简称“新傲科技”）及其控股子公司上海新傲忆翼科技有限公司（以下简称“新傲忆翼”）。本项目计划总投资214,420.80万元，拟投入募集资金200,000万元，全部用于建设投资等资本性支出，其余所需资金通过自筹解决。本项目将完成300mm高端硅基材料的技术研发并进行中间性试验生产，实现工程化制备能力。项目实施后，公司将建立300mm高端硅基材料的供应能力，并完成40万片/年的产能建设。本项目募集资金于2022年3月底到位，原计划建设周期为42个月，包括净化房工程建设、设备采购安装及产能释放、工艺研发及小批量试制、产品认证等阶段。

（二）募投项目延期情况

自资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，截至本公告披露日，本项目已建成产能约8万片/年的300mm SOI硅片试验线，相继突破了倒角与边缘处理、无缺陷超薄介质/硅异质键合与可控剥离、非接触式平坦化、厚度匹配与补偿等核心关键技术，研制了面向功率、射频、硅光等应用的300mm SOI硅片产品，面向多个应用领域的产品已在多家关键客户开展产品验证，正在逐步放量过程中。截至2025年6月30日，募集资金投资进度为28.14%。

然而，在本项目建设过程中，由于以下原因，造成本项目建设进度较原计划有所延缓。（1）由于半导体制造处于新的扩产周期以及全球地缘政治等因素，造成部分关键设备的采购周期、许可证审批及交货周期有所延长；（2）300mm SOI硅片工艺的开发涉及复杂的物理、化学、材料等前沿技术，例如离子共注入技术、无缺陷键合及可控剥离技术等，整个技术与工艺开发完全由项目实施主体自主开展，其研发周期长、技术难度大，较项目预期更为复杂；（3）目前300mm SOI硅片最终应用主要是汽车电子和移动终端，鉴于其应用场景的定位及应用领域的特殊性，客户验证过程异常严格且耗时较长，对项目的整体建设周期造成了一定压力；（4）近几年来，半导体行业整体处于周期性下行阶段，终端应用市场的成长较预期有所放缓，导致对产品的快速市场导入也有所放缓。同时，在对已初步形成一定规模的终端应用市场进行产品导入的同时，公司投入了较多资源在培育并逐步推动国内在面向高压高可靠性高算力等应用领域的新市场的形成，而一个新应用市场的成熟往往需要一定的周期，一定程度上也导致了公司相关产品导入周期延长。

（三）募投项目继续实施的必要性与可行性的论证

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“300mm高端硅基材料研发中试项目”的必要性、可行性进行了重新论证。本次延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

1、项目建设的必要性

（1）新兴终端应用推动SOI硅片技术的发展

SOI硅片作为高端硅基材料的一种，具有寄生电容小、短沟道效应小、低压低功耗、高性能等优势，广泛应用于通信射频前端芯片、功率器件、传感器、硅光子器件等芯片产品。作为与体硅工艺并驾齐驱的差异化技术发展路线，多家国内外知名芯片制造企业已建设基于SOI工艺的芯片制造生产线，广泛应用于智能手机、物联网、汽车电子、人工智能等下游终端市场。同时，全球以及中国SOI生态环境逐步完善，SOI硅片特别是300mm SOI硅片市场开始迎来巨大的发展机遇。

（2）填补国内空白，实现关键技术自主可控

目前，全球能够供应300mm SOI硅片的供应商主要为法国Soitec、日本信越化学以及中国台湾环球晶圆，中国大陆尚无具备规模化生产能力的300mm高端硅基材料的厂商。而子公司新傲科技及新傲忆翼自设立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。本项目建设将有助于公司填补国内各种类300mm高端硅基材料技术能力的空白，为我国半导体产业的差异化发展路线奠定基础。

2、项目建设的可行性

（1）广泛的终端市场需求为项目实施提供良好的市场环境

近年来，半导体市场回暖，在智能手机、物联网、汽车电子、人工智能等下游终端产品的需求拉动下，全球SOI硅片市场规模快速增长。同时，国内外芯片制造企业对基于SOI工艺的芯片制造产能积极布局。芯片制造企业对SOI工艺的规划布局和终端市场的广泛需求为项目实施提供良好的发展契机和市场环境，公司将抓住市场机遇，加强与全球芯片制造企业、设计企业及终端用户的合作，共同建立、健全基于SOI技术的各类芯片设计及制造的生态环境，实现产业集群效应。

（2）公司技术团队具有深厚的技术积累与丰富的从业经验

公司经过多年积累，经过持续的研发投入、试生产、小批量生产、技术调试与客户反馈，逐步完善产品技术和生产工艺，形成了一定的技术积累。公司研发队伍深厚的技术积累与丰富的从业经验共同为本募投项目的建设奠定基础。

（四）结论

综上，从整体市场来看，300mm SOI硅片在其特定应用领域具有一定的优势，具备长期发展潜力。近年来，随着半导体市场的复苏，关键设备的许可证、采购周期等障碍逐步消除，同时，经过多年的技术开发与市场培育，300mm SOI硅片项目与客户紧密配合积极推进了国产SOI衬底材料的发展，目前正在完成产品及工艺的开发，后续将可逐步释放量产，为本项目进一步扩大产能奠定了坚实的基础。因此，为严格把控募投项目的实施质量和效益，经公司审慎研究，拟将本募投项目建设期延长至2026年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向、投资总额和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司募集资金使用管理制度的相关规定，规范使用募集资金。

五、本次部分募投项目延期履行的审议程序

2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的建设期延长至2026年12月。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。除上述事项外，募投项目其他内容均保持不变，本次事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-060

# 上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）[2025]19号），并于2025年8月29日披露《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年6月27日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 重组报告书主要章节 | 修订说明 |
|---|---|
| 重大事项提示 | 更新了锁定期安排、本次交易已经履行及尚未履行的决策程序及报批程序 |
| 第一节 本次交易概况 | 更新了锁定期安排、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序、交易对方关于股份锁定期的承诺函等 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 更新了上市公司基本信息 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 更新了交易对方的基本情况、历史沿革、主要对外投资情况、穿透至最终持有人及穿透锁定情况等 |
| 第四节 标的公司的基本情况 | 更新了标的公司采购情况和主要供应商、租赁房产部分内容 |
| 第五节 本次交易发行股份情况 | 更新了发行股份及支付现金购买资产具体方案之锁定期安排 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 新增部分市场参考案例及可比公司相关数据及分析、补充固定资产及使用权资产折旧政策相关内容 |
| 第十一节 同业竞争与关联交易 | 更新了关联交易的部分数据及表述 |

除上述补充和修订之外，根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，调整了“监事”“股东大会”相关表述，并完善了其他少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-059

# 上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的审核问询函回复的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年7月8日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）[2025]22号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项核实和答复，具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》及相关文件。

本次交易尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：688126　公司简称：沪硅产业

# 上海硅产业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 沪硅产业 | 688126 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 方娜 | 王艳 |
| 电话 | 021-52589038 | 021-52589038 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号 |
| 电子信箱 | pr@sh-nsig.com | pr@sh-nsig.com |

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,166,780.15 | 2,926,984.24 | 8.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,172,154.45 | 1,229,926.01 | -4.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 169,743.27 | 156,940.43 | 8.16 |
| 利润总额 | -53,311.43 | -51,508.40 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,653.82 | -38,855.33 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -48,103.43 | -42,896.27 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,184.96 | -44,456.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.05 | -2.74 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.133 | -0.141 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.133 | -0.141 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.16 | 7.87 | 增加1.29个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 61,338 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 20.64 | 567,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 国有法人 | 19.87 | 546,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司 | 国有法人 | 4.76 | 130,840,945 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.45 | 122,134,295 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海新傲科技集团有限公司 | 国有法人 | 3.90 | 107,152,572 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3.32 | 91,121,013 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期投份有限公司 | 国有法人 | 2.62 | 72,011,521 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.48 | 68,248,899 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.27 | 62,476,953 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.54 | 42,316,451 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | / | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | / | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 23沪硅K1 | 240187 | 2023-11-17 | 2028-11-17 | 13.4 | 3.17 |
| 上海硅产业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 24 沪硅产业 MTN001 | 102484726 | 2024-10-29 | 2029-10-31 | 5 | 0.0268 |
| 上海硅产业集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据) | 25 沪硅产业 MTN001（科创票据） | 102581788 | 2025-04-22 | 2030-04-23 | 10 | 0.0240 |

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 39.78 | 34.4 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.57 | 0.23 |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2025-055

# 上海硅产业集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,038,399股，每股面值人民币1元，募集资金总额为4,999,999,851.17元，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币24,405.71万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 再融资募集资金专户年初金额 | 11,031.98 |
| 加:年初用于现金管理金额 | 143,000.00 |
| 再融资募集资金年初金额 | 154,031.98 |
| 减:本年度直接投入募投项目 | 796.76 |
| 用于现金管理金额 | 130,000.00 |
| 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,170.49 |
| 再融资募集资金专户期末余额 | 24,405.71 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。2025年8月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的向特定对象发行A股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 | 存款方式 | 余额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 上海银行嘉定支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 03004841882 | 活期 | 10,393.32 |
| 上海银行嘉定支行 | 上海新傲科技股份有限公司 | 03004911414 | 活期 | 5,347.35 |
| 上海银行嘉定支行 | 上海新傲忆翼科技有限公司 | 03005771225 | 活期 | 8,665.04 |
| 合计 | | | | 24,405.71 |

因集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、补充流动性资金项目实施完毕，2024年度公司已办理完毕下述募集资金专户的销户手续：

| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 |
|---|---|---|
| 平安银行上海南京西路支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 15981666888880 |
| 中国银行上海市张江高科技园区支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 457282551286 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 121921770510806 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇晶投半导体科技有限公司 | 121945833410718 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇晶科半导体科技有限公司 | 121945865110918 |

（二）募集资金三方(四方)监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2022年2月，公司及保荐机构分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年5月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年6月，公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司（以下简称“新傲科技”）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月，公司及保荐机构与上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称“晶昇新诚”；后更名为“上海新昇晶投半导体科技有限公司”，以下简称“新昇晶投”）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。于2024年5月，公司及保荐机构与新傲科技、上海新傲忆翼科技有限公司（以下简称“新傲忆翼”）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见“二、（一）募集资金管理情况”。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件1：2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2022年5月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,941.99万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第4117号）。

2022年6月24日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司使用募集资金14,941.99万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过200,000万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。监事会发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年4月22日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过160,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐人出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为130,000万元，具体情况如下：

| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 认购日 | 到期日 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行嘉定支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 2025-4-25 | 2025-7-25 | 保本固定收益 | 1.35% | 否 |
| 上海银行嘉定支行 | 定期存款 | 100,000.00 | 2025-4-25 | 2025-10-25 | 保本固定收益 | 1.70% | 否 |
| 上海银行嘉定支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025-5-8 | 2025-8-6 | 保本浮动收益 | 1.83% | 否 |
| 合计 | / | 130,000.00 | / | / | / | / | / |

2025年半年度，公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为393,000万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为406,000万元，实现收益788.57万元。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（六）节余募集资金使用情况

募投项目集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目及补充流动性资金共节余募集资金739.42万元，系利息收入并已于2024年度全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，相关专户注销情况参见“二、（一）募集资金管理情况”。

（七）募集资金使用的其他情况

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，同意项目的原实施主体上海新昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后，再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项做等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意控股子公司新傲科技使用募集资金不超过人民币7.65亿元向其控股子公司新傲忆翼实缴注册资本，并自决议通过之日起以募集资金合计向新傲科技、新傲忆翼提供不超过人民币12亿元借款，以专项实施募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更及增加募投项目实施主体的情况

2022年5月25日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议，并于2022年6月10日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，募投项目“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”原实施主体上海新昇以募集资金15亿元投资并控股晶昇新诚（后更名为“新昇晶投”）、再由晶昇新诚（后更名为“新昇晶投”）以募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司新昇晶科，并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。由于上述募投项目实施主体变更事项，新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加控股子公司新傲忆翼为募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的实施主体，项目实施地点仍为上海。由于上述增加募投项目实施主体的事项，新傲忆翼在上海银行股份有限公司市北分行开设账户作为募集资金专项账户。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募